

证券代码：873793

证券简称：合通股份

主办券商：东莞证券

广东合通建业科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务	出售产品、商品	20,000,000	4,702,452	实际业务需要
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	20,000,000	4,702,452	-

(二) 基本情况

1、本次关联交易的关联方基本情况：

（1）法人及其他经济组织

名称：广东全芯半导体有限公司

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区南山路一号中集智谷4号楼C户

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区南山路一号中集智谷4号楼C户

企业类型：其他有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李锦光

实际控制人：李锦光

主营业务：研发、生产、加工、销售：半导体芯片、计算机存储卡及移动存储产品、高密度印刷电路板、半导体设备、电子材料、电子产品、元器件贴片；半导体集成电路的封装、测试及技术开发；芯片设计；物业管理；实业投资；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（加工另设分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（2）关联关系

广东全芯半导体有限公司的法定代表人、实际控制人李锦光，是本公司董事长李鸿光之兄弟，是本公司总经理陈子安配偶之兄长，本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年04月18日，公司召开第三届董事会第十三次会议已审议通过《关于预计2024年日常关联交易的议案》，议案表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票，董事李鸿光，陈子安回避表决。该议案尚需提交2023年年度股东大会审议批准。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述预计关联交易是公司未来经营和业务需要，属于正常的商业交易行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定，定价公允合理，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。

（二） 交易定价的公允性

公司及其关联方公司均进行独立决策，公司的关联方客户均是通过正常营销途径获得，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易，基于公司正常业务运营所产生，并有助于公司业务的开展。上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易符合相关程序，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司股东权益的情形。

六、 备查文件目录

《广东合通建业科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东合通建业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日